



CASA
第三代半导体产业技术创新战略联盟
China advanced semiconductor industry
innovation alliance

第三代半导体产业技术创新战略联盟

关于召开第二届第三代半导体材料及装备发展研讨会 的通知

各有关单位：

您好！为加强第三代半导体材料与装备企业之间，以及装备企业与产业链上下游企业之间的互动交流与协同合作，推进“材料、工艺、装备一体化”发展，研发自主创新的国产化装备，实现第三代半导体产业的全面技术突破，缓解“卡脖子”问题，第三代半导体产业技术创新战略联盟装备委员会拟于2020年9月4日举办“第二届第三代半导体材料及装备发展研讨会”，邀请产业链上下游、设备及关键零部件研究、生产单位专家代表共同深入研讨，为行业发展群策群力。

诚挚邀请您出席指导，探讨我国第三代半导体产业的发展。感谢您的支持！

会议地点：中科院半导体所学术报告厅（北京海淀区林大北路）

联系人：李娟 18910499109 lijuan@casa-china.cn

杨峻骅 13704812577 casa@casa-china.cn

- 附件：
1. 会议日程
 2. 会议须知
 3. 参会回执

第三代半导体产业技术创新战略联盟

二〇二〇年八月十日





附件 1:

第二届第三代半导体材料及装备发展研讨会
会议日程（拟）

时间安排	报告内容及嘉宾
9:00-9:05	主持人背景及嘉宾介绍
9:05-9:15	领导致词
9:15-9:40	新形势下我国第三代半导体产业面临的问题和发展机遇 沈波 北京大学教授，联盟副理事长
9:40-10:00	半导体关键装备的现状 & 国产化思考 唐景庭 中电 13 所副所长 联盟装备委员会共同主任
10:00-10:20	集成电路制造装备需求 康劲 中芯国际北京创新中心总经理
10:20-10:40	休息
10:40-11:00	SiC 器件制造关键装备发展趋势及国产化进展 巩小亮 中国电科 48 所高级工程师，湖南大学兼职教授
11:00-11:20	碳化硅外延产线中的设备更新需求 孔令沂 东莞市天域半导体科技有限公司生产总监
11:20-11:40	题目待定 杨霏 国家电网公司全球能源互联网研究院教授级高级工程师
11:40-12:00	北方华创设备研发进展及国产装备发展建议 李谦 北京北方华创微电子装备有限公司副总裁
合影、午餐	
13:30-13:50	氮化镓研发进展及生产线技术要求 英诺赛科
13:50-14:10	中微设备研发进展及国产装备发展建议 郭世平 中微半导体设备（上海）股份有限公司副总裁
14:10-14:30	晶体材料生长及装备研究进展 赵然 国宏中宇科技发展有限公司总经理，联盟装备委员会副主任
14:30-14:50	产业链协同发展加快推动半导体装备国产化 陈爱华 中晟光电设备（上海）股份有限公司董事长
14:50-15:10	激光技术在第三代半导体领域的应用 李春昊 大族激光科技产业集团股份有限公司半导体事业部博士
15:10-15:30	茶歇
15:30-17:00	圆桌讨论：关键装备国产化的突破口及创新模式 1、“十四五”技术突破重点及项目建议 2、组织模式及市场突破口 3、标准及专利如何布局



附件 2:

会议须知

1. 鉴于新冠疫情，参会者请自备口罩。与会前请提前 10 分钟到达中科院半导体所北门，按要求扫码登记进入，并遵守现场防疫规定；
2. 报到期间，请您保管好自己的随身物品；
3. 参会费用：
 - (1) 联盟会员单位免费，提供中午工作餐；
 - (2) 非会员单位：800 元/人（含午餐），可现场支付宝报名；
4. 会议期间请将手机调至无声、振动状态。

会务联系人：李 娟 18910499109 lijuan@casa-china.cn

杨峻骅 13704812577 casa@casa-china.cn



附件 3:

第二届第三代半导体材料及装备发展研讨会

回执表（可复制多填）

单位名称			
姓名		职务	
手机		邮箱	

参会回执于 8 月 30 日前发电子邮件至联盟秘书处 casa@casa-china.cn